

2017-2022年中国集成电路 封装市场调查与行业竞争对手分析报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国集成电路封装市场调查与行业竞争对手分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/Z227199032.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

经过60多年的发展，集成电路产业随着电子产品小型化、智能化、多功能化的发展趋势，技术水平、产品结构、产业规模等都取得举世瞩目的成就。就集成电路封装类型而言，在它的三个阶段发展过程中，已出现了几十种不同外型尺寸、不同引线结构、不同引线间距、不同连接方式的电路。由于它们对应不同的应用需求，如，在功能上有大功率、多引线、高频、光电转换等，在中国及全球多元化的市场上，目前及未来较长一段时间内都将呈现并存发展的格局：（1）直插封装工艺成熟、操作简单、功能较单一，虽然市场需求呈缓慢下降的趋势，但今后几年内仍有巨大的市场空间；（2）表面贴装工艺中，两边或四边引线封装技术如SOP、PLCC、QFP、QFN、DFN等已发展成熟，由于其引脚密度大大增加且可实现较多功能，应用非常普遍，目前拥有三类中最大的市场容量，未来几年总体规模将保持稳定；面积阵列封装技术如WLCSP、BGA、LGA、CSP等技术含量较高、集成度更高，现阶段产品利润高，产品市场处于快速增长阶段，但基数仍然相对较小；（3）高密度封装工艺如3D堆叠、TSV等仍处于研发阶段，鉴于该类技术在提高封装密度方面的优异表现，待实用化后将迎来巨大的市场空间。

我国目前集成电路封装市场中，DIP、SOP、QFP、QFN/DFN等传统封装仍占据我国市场的主体，约占70%以上的封装市场份额；BGA、CSP、WLCSP、FC、TSV、3D堆叠等先进封装技术只占到总产量的约20%。主要市场参与者包括大量的中小企业、部分技术领先的国内企业和合资企业，市场竞争最为激烈。华润安盛科技等中等规模国内企业由于工艺成熟、在直插封装和表面贴装中的两边或四边引线封装方面有技术创新，质量管理和成本控制领先。近几年来，经济社会效益好，企业发展快。在表面贴装的面积阵列封装领域，除了有技术、市场优势的跨国企业外，我国长电科技、通富微电、华天科技等企业凭借其自身的技术优势和国家重大科技专项的支持，逐步接近甚至部分超越了国际先进水平。高密度封装工艺目前仍处于研发阶段，尚未实现量产。

国内集成电路封装测试行业竞争特征

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国集成电路封装市场调查与行业竞争对手分析报告》共八章。首先介绍了集成电路封装行业市场发展环境、集成电路封装整体运行态势等，接着分析了集成电路封装行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路封装市场竞争格局。随后，报告对集成电路封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路封装行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业发展背景 17

1.1 集成电路封装行业定义及分类 17

1.1.1 集成电路封装行业定义 17

1.1.2 集成电路封装行业产品大类 17

1.1.3 集成电路封装行业特性分析 18

（1）行业周期性 18

（2）行业区域性 18

（3）行业季节性 18

1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 18

1.2 集成电路封装行业政策环境分析 19

1.2.1 行业管理体制 19

1.2.2 行业相关政策 20

（1）《电子信息产业调整和振兴规划》 20

（2）《集成电路产业“十三五”发展规划》 21

（3）发改委加大对集成电路行业的支持力度 25

（4）科技部重点支持集成电路重点专项 25

（5）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 26

（6）海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施 27

1.3 集成电路封装行业经济环境分析 28

1.3.1 国际宏观经济走势分析及预测 28

（1）国际宏观经济现状 28

（2）国际宏观经济预测 30

1.3.2 国内宏观经济走势分析及预测 33

（1）GDP增长情况分析 33

（2）工业经济增长分析 34

（3）固定资产投资情况 34

- (4) 社会消费品零售总额 35
- (5) 进出口总额及其增长 36
- (6) 货币供应量及其贷款 36
- (7) 居民消费者价格指数 37
- 1.4 集成电路封装行业技术环境分析 38
 - 1.4.1 集成电路封装技术演进分析 38
 - 1.4.2 集成电路封装形式应用领域 39
 - 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析 40
 - 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 41

第2章：中国集成电路产业发展分析 45

2.1 集成电路产业发展状况 45

2016年1-6月止累计中国集成电路产量599.3亿块。2015年我国集成电路行业产量约1087亿块，同比2014年的1034.83亿块增长了5.04%，近几年我国集成电路行业产量情况如下图所示：

2006-2016年全国集成电路产量分析		时间	年度产量（亿块）	同比增长（%）
2006	374.21	--		
2007	416.07	11.19		
2008	417.15	0.26		
2009	415.93	-0.29		
2010	652.69	56.92		
2011	761.88	16.73		
2012	830.31	8.98		
2013	867.64	4.50		
2014	1034.83	19.27		
2015	1087.00	5.04		
2016年1-6月	599.3	16.5		

2.1.1 集成电路产业链简介 45

2.1.2 集成电路产业发展现状分析 45

- (1) 行业发展势头良好 45
- (2) 行业技术水平快速提升 47
- (3) 行业竞争力仍有待加强 48
- (4) 产业结构进一步优化 48

2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 48

- (1) 三大区域集聚发展格局业已形成 49
- (2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征 50
- (3) 产业整体将“有聚有分，东进西移” 51

2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 52

- (1) 产业政策环境进一步向好 52
- (2) 战略性新兴产业将加速发展 52

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会	53
2.1.5 集成电路产业面临的主要问题	53
(1) 规模小	53
(2) 创新不足	54
(3) 价值链整合不够	54
(4) 产业链不完善	54
2.1.6 集成电路产业“十三五”发展预测	54
2.2 集成电路设计业发展状况	55
2.2.1 集成电路设计业发展概况	55
2.2.2 集成电路设计业发展特征	55
(1) 产业规模持续扩大	55
(2) 质量上升数量下降	56
(3) 企业规模持续扩大	57
(4) 技术能力大幅提升	57
2.2.3 集成电路设计业发展隐忧	57
2.2.4 集成电路设计业新发展策略	57
2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测	58
2.3 集成电路制造业发展状况	58
2.3.1 集成电路制造业发展现状分析	58
(1) 集成电路制造业发展总体概况	58
(2) 集成电路制造业发展主要特点	59
(3) 集成电路制造业规模及财务指标分析	59
1) 集成电路制造业规模分析	59
2) 集成电路制造业盈利能力分析	60
3) 集成电路制造业运营能力分析	60
4) 集成电路制造业偿债能力分析	61
5) 集成电路制造业发展能力分析	61
2.3.2 集成电路制造业经济指标分析	62
(1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素	62
(2) 集成电路制造业经济指标分析	62
(3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析	63
(4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析	66

- (5) 不同地区企业经济指标分析 68
- 2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析 81
 - (1) 全国集成电路制造业供给情况分析 81
 - 1) 全国集成电路制造业总产值分析 81
 - 2) 全国集成电路制造业产成品分析 81
 - (2) 全国集成电路制造业需求情况分析 82
 - 1) 全国集成电路制造业销售产值分析 82
 - 2) 全国集成电路制造业销售收入分析 82
 - (3) 全国集成电路制造业产销率分析 83
- 2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测 84

第3章：中国集成电路封装行业发展分析 85

- 3.1 半导体行业发展分析 85
 - 3.1.1 半导体行业指数对比分析 85
 - (1) 费城半导体指数与道琼斯指数 85
 - (2) 台湾电子零组件指数与台湾加权指数 85
 - (3) CSRC电子行业指数与沪深300指数 86
 - 3.1.2 全球半导体产销分析 86
 - (1) 全球半导体产值情况 86
 - (2) 全球半导体销售情况 88
 - 3.1.3 全球半导体行业主要企业情况 92
 - (1) 全球半导体10强 92
 - (2) 全球领先半导体情况 93
 - 3.1.4 中国半导体行业发展概况 94
 - 3.1.5 半导体设备BB值分析 95
 - 3.1.6 半导体行业景气预测 97
 - 3.1.7 半导体行业发展趋势 99
 - (1) 产业链向专业化分工转型 99
 - (2) 综合厂商向轻资产转型 99
 - (3) 封装环节产值逐年成长 100
 - (4) 封装环节外包也是趋势 101
- 3.2 集成电路封装行业发展分析 101

- 3.2.1 集成电路封装行业规模分析 101
- 3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析 102
- 3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析 103
- 3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较 103
- 3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析 104
 - (1) 有利因素 104
 - (2) 不利因素 105
- 3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测 106
 - (1) 发展趋势分析 106
 - (2) 前景预测 108
- 3.3 集成电路封装类专利分析 108
 - 3.3.1 专利分析样本构成 108
 - (1) 数据库选择 108
 - (2) 检索方式 108
 - 3.3.2 封装类专利分析 108
 - (1) 专利公开年度趋势 108
 - (2) 国内外专利公开趋势对比 109
 - (3) 国内专利公开主要省市分布 110
 - (4) IPC技术分类趋势分布 111
 - (5) 主要权利人分布情况 112
- 3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨 112
 - 3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 112
 - (1) 封装开裂的影响因素分析 112
 - (2) 管控影响开裂的因素的方法分析 114
 - 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 114
 - (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析 115
 - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法 115

第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 118

- 4.1 集成电路市场分析 118
 - 4.1.1 集成电路市场规模 118
 - 4.1.2 集成电路市场结构分析 118

- (1) 集成电路市场产品结构分析 118
- (2) 集成电路市场应用结构分析 119
- 4.1.3 集成电路市场竞争格局 119
- 4.1.4 集成电路国内市场自给率 120
- 4.1.5 集成电路市场发展预测 121
- 4.2 集成电路封装行业需求分析 121
- 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析 121
 - (1) 计算机市场发展现状 122
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用 122
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动 123
- 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 124
 - (1) 消费电子市场发展现状 124
 - (2) 集成电路在消费电子领域的应用 128
 - (3) 消费电子领域对行业需求的拉动 128
- 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 128
 - (1) 通信设备市场发展现状 128
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用 129
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动 130
- 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析 130
 - (1) 工控设备市场发展现状 130
 - (2) 集成电路在工控设备领域的应用 131
 - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动 132
- 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 132
 - (1) 汽车电子市场发展现状 132
 - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用 133
 - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动 133
- 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 133

第5章：中国集成电路封装行业市场竞争分析 135

5.1 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 135

5.1.1 现有竞争者之间的竞争 135

5.1.2 关键要素的供应商议价能力分析 136

- 5.1.3 消费者议价能力分析 136
- 5.1.4 行业潜在进入者分析 136
- 5.1.5 替代品风险分析 137
- 5.2 集成电路封装行业国际竞争格局分析 137
 - 5.2.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 137
 - 5.2.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析 138
 - 5.2.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 139
 - (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 139
 - (2) 主板材料的变化趋势 142
 - 5.2.4 跨国企业在华市场竞争力分析 143
 - (1) 台湾日月光集团竞争力分析 143
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析 145
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - (3) 台湾矽品公司竞争力分析 146
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析 148
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析 148
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - (6) 飞思卡尔公司竞争力分析 149
 - (1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析	
(3) 企业经营优劣势分析	
(7) 英飞凌科技公司竞争力分析	150
(1) 企业发展简况分析	
(2) 企业经营情况分析	
(3) 企业经营优劣势分析	
5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析	152
5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析	152
5.3.2 国内集成电路封装行业集中度分析	153
(1) 行业销售收入集中度分析	153
(2) 行业利润集中度分析	154
(3) 行业工业总产值集中度分析	155
5.3.3 中国集成电路封装行业国际竞争力分析	156
第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析	157
6.1 集成电路封装行业BGA产品市场分析	157
6.1.1 BGA封装技术水平	157
6.1.2 BGA产品主要应用领域	159
6.1.3 BGA产品需求拉动因素	159
6.1.4 BGA产品市场规模分析	160
6.1.5 BGA产品市场前景展望	160
6.2 集成电路封装行业SIP产品市场分析	161
6.2.1 SIP封装技术水平	161
6.2.2 SIP产品主要应用领域	163
6.2.3 SIP产品需求拉动因素	164
6.2.4 SIP产品市场规模分析	164
6.2.5 SIP产品市场前景展望	165
6.3 集成电路封装行业SOP产品市场分析	165
6.3.1 SOP封装技术水平	165
6.3.2 SOP产品主要应用领域	166
6.3.3 SOP产品市场发展现状	167
6.3.4 SOP产品市场前景展望	168

6.4 集成电路封装行业QFP产品市场分析	168
6.4.1 QFP封装技术水平	168
6.4.2 QFP产品主要应用领域	169
6.4.3 QFP产品市场发展现状	169
6.4.4 QFP产品市场前景展望	170
6.5 集成电路封装行业QFN产品市场分析	170
6.5.1 QFN封装技术水平	170
6.5.2 QFN产品主要应用领域	172
6.5.3 QFN产品市场发展现状	172
6.5.4 QFN产品市场前景展望	172
6.6 集成电路封装行业MCM产品市场分析	173
6.6.1 MCM封装技术水平概况	173
(1) 概念简介	173
(2) MCM封装分类	173
6.6.2 MCM产品主要应用领域	173
6.6.3 MCM产品需求拉动因素	174
6.6.4 MCM产品市场发展现状	175
6.6.5 MCM产品市场前景展望	176
6.7 集成电路封装行业CSP产品市场分析	177
6.7.1 CSP封装技术水平概况	177
(1) 概念简介	177
(2) CSP产品特点	178
(3) CSP封装分类	179
(4) CSP封装工艺流程	180
6.7.2 CSP产品主要应用领域	181
6.7.3 CSP产品市场发展现状	182
6.7.4 CSP产品市场前景展望	183
6.8 集成电路封装行业其他产品市场分析	183
6.8.1 晶圆级封装市场分析	183
(1) 概念简介	183
(2) 产品特点	184
(3) 主要应用领域	186

(4) 市场规模与主要供应商 187

(5) 前景展望 188

6.8.2 覆晶/倒封装市场分析 188

(1) 概念简介 188

(2) 产品特点 188

(3) 市场前景 188

6.8.3 3D封装市场分析 188

(1) 概念简介 189

(2) 封装方法 189

(3) 发展现状与前景 189

第7章：中国集成电路封装行业主要经营分析 191

7.1 集成电路封装企业发展总体状况分析 191

7.1.1 集成电路封装行业制造商工业总产值排名 191

7.1.2 集成电路封装行业制造商销售收入排名 191

7.1.3 集成电路封装行业制造商利润总额排名 192

7.2 集成电路封装行业领先企业个案分析 193

7.2.1 飞思卡尔半导体(中国)有限公司经营情况分析 193

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.2 威讯联合半导体(北京)有限公司经营情况分析 196

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 200

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析 207

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 210

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

⋯⋯另有23家企业分析。

第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议 304 (ZY LII)

8.1 集成电路封装行业投资特性分析 304

8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒 304

(1) 技术壁垒 304

(2) 资金壁垒 304

(3) 人才壁垒 304

(4) 严格的客户认证制度 304

8.1.2 集成电路封装行业盈利模式 305

8.1.3 集成电路封装行业盈利因素 305

8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析 306

8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况 306

8.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 306

8.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 309

(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析 309

(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析 310

(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析 311

8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析 312

8.3 集成电路封装行业投融资分析 313

8.3.1 电子发展基金对集成电路产业的扶持分析 313

(1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况 313

(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议 314

8.3.2 集成电路封装行业融资成本分析 315

8.3.3 半导体行业资本支出分析 315

8.4 集成电路封装行业投资建议 317

8.4.1 集成电路封装行业投资机会分析 317

8.4.2 集成电路封装行业投资风险分析 317

8.4.3 集成电路封装行业投资建议 320

(1) 投资区域建议 320

(2) 投资产品建议 321 (ZY LII)

(3) 技术升级建议 321

图表目录：

图表1：2010-2015年世界经济增长率及预测（季度环比折年率，%） 31

图表2：2011-2015年中国国内生产总值同比增长速度（单位：%） 33

图表3：2011-2015年中国规模以上工业增加值增速（单位：%） 34

图表4：2015年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 35

图表5：2015年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%） 35

图表6：2013-2015年中国货物进出口总额（单位：亿美元） 36

图表7：2011-2015年中国广义货币（M2）增长速度（单位：%） 37

图表8：2011-2015年中国居民消费者价格指数同比增长情况（单位：%） 37

图表9：封装技术的演进 38

图表10：各种集成电路封装形式应用领域 39

图表11：集成电路封装工艺流程 40

图表12：集成电路产业链示意图 45

图表13：2013-2015年中国集成电路销售额增长趋势（单位：亿元，%） 46

图表14：2013-2015年中国集成电路产量及增长情况（单位：万块，%） 47

图表15：2013-2015年中国半导体销售额增长趋势（单位：亿元，%） 47

图表16：中国集成电路产业长三角地区分布概况 49

图表17：2015年中国集成电路进口统计（单位：亿个；美元/个） 53

图表18：2013-2015年中国集成电路产业销售情况（单位：亿元；%） 56

图表19：2011-2015年集成电路制造业规模分析（单位：家，人，万元） 59

图表20：2011-2015年中国集成电路制造业盈利能力分析（单位：%） 60

图表21：2011-2015年中国集成电路制造业运营能力分析（单位：次） 60

图表22：2011-2015年中国集成电路制造业偿债能力分析（单位：%、倍） 61

图表23：2011-2015年中国集成电路制造业发展能力分析（单位：%） 61

图表24：2011-2015年集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 63

图表25：2013-2015年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 64

图表26：2013-2015年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 64

图表27：2013-2015年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 65

图表28：2013-2015年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 65

图表29：2013-2015年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 66

图表30：2013-2015年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 66

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/Z227199032.html>